



Liebe IMAPS-Mitglieder,

nachdem die ganze Welt im Jahr 2020 von der Covid-19-Pandemie überrascht und überrollt wurde, konnte sich ganz Deutschland 2021 organisatorisch und hoffentlich auch mental etwas besser auf den Ausnahmezustand einstellen, auch wenn es bezüglich der bund- und länderspezifischen Verhaltensregelungen teilweise nicht leichtfiel. So war es ein weiteres Jahr voller Herausforderungen.

Da der Austausch in Wissenschaft und Forschung nicht zum Stehen kommen darf, haben wir in den zurückliegenden Monaten stets nach Lösungen gesucht, um mit Mitstreiterinnen und Mitstreitern auf dem Gebiet des Advanced Packaging in Kontakt zu bleiben.

Veranstaltungen 2021

Nach der ersatzlosen Streichung des IMAPS Frühjahrseminars wegen zu hoher Infektionszahlen konnten wir uns dann endlich am 21. und 22. Oktober 2021 auf der IMAPS Herbsttagung an der Hochschule München zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in Präsenz treffen. Unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln war ein großartiges Beisammensein möglich, das die 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und 13 Ausstellenden sichtlich zu genießen schienen. Das Vortragsprogramm mit knapp 20 Referierenden deckte ein breites Themenspektrum der Aufbau- und Verbindungstechnik ab: vom Sintern/Löten und der Leistungselektronik über Gehäusetechnologie sowie Zuverlässigkeit, Analyse und Test bis hin zu

Keramiksubstraten, Materialien und Prozessen. Der ‚Best Presentation Award‘ für herausragende wissenschaftliche Abhandlungen wurde an Dr.-Ing. Kathrin Reinhardt vom Fraunhofer IKTS für ihre Ausführungen zu ‚Fotostrukturierbare Pasten – Neueste Innovationen in der Fineline-Dickschichttechnik‘ verliehen. An dieser Stelle nochmals herzlichen Glückwunsch zu der wohlverdienten Auszeichnung! Mit Budatek, EKRA, Koenen, Microtronic, Via Electronic und XYZTEC unterstützten gleich sechs namhafte Sponsoren die Konferenz. Selbstverständlich durfte auch der gemeinsame bayerische Abend im Wirtshaus Augustiner nicht fehlen, den die Teilnehmenden zum gedanklichen Austausch nutzten.

Neben der IMAPS Herbsttagung konnte nur die Advanced Packaging Konferenz auf der SEMICON EUROPA als Vor-Ort-Event in München durchgeführt werden. An der Konferenz Mitte November war IMAPS wieder einmal als Unterstützer beteiligt. Alle anderen Konferenzen, die für IMAPS Deutschland von Interesse sind, wurden entweder abgesagt oder online bzw. hybrid abgehalten. Dies betraf bedauerlicherweise selbst die EMPC 2021 (13.-16.09.2021), deren Teilnehmende sich nicht wie erhofft in Göteborg, sondern auf einer Onlineplattform versammelten. Darüber hinaus organisierten einige IMAPS Chapter Webinare oder Online-Workshops, was auf großen Anklang in der Community stieß. Weitere Informationen zu unseren Aktivitäten und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Website www.imaps.de.

Was wird 2022 bringen?

Wie sich das Jahr 2022 entwickeln wird und ob die geplanten Präsenzveranstaltungen so umgesetzt werden können, wie wir es uns erhoffen, hängt natürlich stark vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Den Auftakt des Jahres bildet die 11. DVS/GMM-Fachtagung am 2. und 3. März 2022 auf der EBL 2022 in Fellbach, die sich dem Thema ‚Elektronische Baugruppen und Leiterplatten – Intelligentes Design, intelligente Fertigung, Prüfung und Anwendung‘ widmen wird und an der IMAPS Deutschland wie gewohnt als Partner und Unterstützer beteiligt sein wird.

Aller Voraussicht nach wird es leider kein eigenes IMAPS Frühjahrsseminar geben, dafür wird jedoch IMAPS Deutschland bei der CICMT 2022 als Co-Organisator fungieren. Die CICMT wechselt geografisch zwischen den USA, Europa und Asien, um die Zusammenarbeit, die Vernetzung und den Austausch technischer Informationen zwischen diesen geografischen Industriezentren zu verbessern. Als nächstes wird die Konferenz in Österreich Halt machen, wo sie vom 13. bis 15. Juli 2022 in der Wirtschaftskammer Wien hoffentlich in Präsenz stattfinden kann. Wie üblich wird sich drei Tage lang alles um keramische Verbindungstechniken und Mikrosysteme drehen.

Nachdem die von den Kolleginnen und Kollegen der IEEE Electronics Packaging Society organisierte Electronics System-Integration Technology Conference (ESTC) im Jahr 2020 pandemiebedingt online abgehalten werden musste, ist nun vom 13. bis 16. September 2022 wieder eine Präsenzveranstaltung geplant. Nach Stopps in Dresden, Greenwich, Berlin, Amsterdam, Helsinki und Grenoble verschlägt es die

ESTC im kommenden Jahr bei ihrer neunten Auflage zum ersten Mal nach Rumänien in die Stadt Sibiu. Als Unterstützer der Konferenz drückt IMAPS Europe den Veranstaltern ganz fest die Daumen und hofft, dass sich die Erfolge der Vergangenheit wiederholen lassen bzw. getoppt werden.

Im vierten Quartal erwarten Sie gleich zwei Highlights in München: Auf die IMAPS Herbsttagung im Oktober folgt im November die SEMICON EUROPA (15.-18.11.2022) mit der Advanced Packaging Conference am letzten Messetag. Außerdem veranstalten unsere Kolleginnen und Kollegen von IMAPS USA vom 3. bis 6. Oktober 2022 das 55th International Symposium on Microelectronics in Boston (USA).

Abschließend möchte ich mich bei allen Vereinsmitgliedern für ihre Mitarbeit im vergangenen Jahr bedanken. Wie jeder Verein leben auch wir von den Aktivitäten unserer Mitglieder und können nur deshalb so erfolgreich agieren, weil Sie uns in vielerlei Hinsicht (Fachvortrag, Ausstellung, Sponsoring) und als aktiv Netzwerkende unterstützen.

Der gesamte erweiterte Vorstand wünscht Ihnen und Ihren Familien entspannte Feiertage und Gesundheit, Glück und Erfolg für das kommende Jahr. Bleiben Sie uns gewogen und passen Sie weiterhin gut auf sich auf!

Herzlichst,

Ihr

Martin Schneider-Ramelow

■ Neuer Mitstreiter im erweiterten Vorstand von IMAPS Deutschland e. V.

Der Verein IMAPS Deutschland engagiert sich vielseitig in seiner Eigenschaft als Plattform für alle, deren Schwerpunkt in den Bereichen Aufbau- und Verbindungstechnik und Mikroelektronik liegt. In den Bereichen der Öffentlichkeitsarbeit in Print- und elektronischen Medien sowie bei den IMAPS-Veranstaltungen wird der Vorstand durch den sogenannten ‚erweiterten Vorstand‘ unterstützt. Unter anderem

betrifft dies die Akquise und Bereitstellung von Beiträgen für unsere Vereinsseiten hier in der *PLUS*. Seit Ende dieses Jahres wird der Bereich der Öffentlichkeitsarbeit durch ein weiteres Mitglied im erweiterten Vorstand ergänzt.

Matthias Lorenz ist seit 2001 Key Account Manager beim Mikrosystemtechnik-Unternehmen AEMtec in Berlin-Adlershof. Von 2012 bis 2020 lag der Schwer-



Dipl.-Ing. Matthias Lorenz

punkt seiner Tätigkeit in der Geschäftsentwicklung im Bereich Medizintechnik in Europa und Nordamerika. Seit 2021 ist er Leiter für das Geschäftsfeld Skandinavien. Zuvor war der Diplom-Ingenieur für Feinwerktechnik und Mikrosystemtechnik in verschiedenen leitenden Funktionen bei Unternehmen der Daten- und Telekommunikation beschäf-

tigt (QUANTE Fernmeldemontagen GmbH und LEWRON Kommunikationssysteme & Consulting GmbH). Seit 2014 ist er Vorstandsmitglied beim IVAM e.V., einem internationalen Fachverband für Mikrotechnik mit Sitz in Dortmund.

Wir freuen uns, Matthias Lorenz im Team des erweiterten Vorstandes begrüßen zu können, wünschen uns und unseren Mitgliedern eine gute Zusammenarbeit.

Hinweis an alle IMAPS-Mitglieder – Nutzen Sie das PLUS-Online-Archiv!!

Jede Mitgliedschaft ist verbunden mit einem Abonnement der Fachzeitschrift *PLUS* des Eugen G. Leuze Verlags. Dazu gehört auch ein Zugriff auf das Online-Archiv der Zeitschrift.

Über den folgenden Link können Sie sich die Inhalte aus dem Archiv anzeigen lassen:

<https://www.leuze-verlag.de/fachzeitschriften/plus/artikelarchiv-plus>

Entsprechende Filter unterstützen die Artikelsuche. Zum Lesen oder Herunterladen ist jede Mitgliedschaft mit einem LOGIN verknüpft.

■ Veranstaltungskalender

Ort	Zeitraum	Name	Veranstalter
Fellbach	2./3.03.2022	EBL 2022	DVS u. GMM (IMAPS D als Partner)
Fountain Hills	7.-10. März 2022	Device Packaging 2022	IMAPS USA
Göteborg	12.-14.06.2022	NordPac 2022	IMAPS Nordic
Wien	13.-15. Juli 2022	CICMT 2022	IMAPS/ACerS
Sibiu (Rumänien)	13.-16. Sept. 2022	ESTC 2022	IEEE-CPMT, IMAPS Europe
Berlin	26.-29. Sept. 2022	ESREF 2022	Fraunhofer IZM, TU Berlin, MCC Agentur
Boston	3.-6.10.2022	International Symposium on Microelectronics	IMAPS USA
München	Okt. 2022	Herbstkonferenz	IMAPS D
München	Nov. 2022	SEMICON EUROPA	SEMI Europa

Dieser Kalender gilt unter Vorbehalt. Bitte beachten Sie die Informationen und Hinweise der Veranstalter auf den entsprechenden Webseiten!

■ IMAPS Deutschland – Ihre Vereinigung für Aufbau- und Verbindungstechnik

IMAPS Deutschland, Teil der ‚International Microelectronics and Packaging Society‘ (IMAPS), stellt seit 1973 in Deutschland das Forum für alle dar, die sich mit Mikroelektronik und Aufbau- und Verbindungstechnik beschäftigen. Mit fast 300 Mitgliedern verfolgen wir im Wesentlichen drei wichtige Ziele:

- wir verbinden Wissenschaft und Praxis
- wir sorgen für den Informationsaustausch unter unseren Mitgliedern und
- wir vertreten den Standpunkt unserer Mitglieder in internationalen Gremien.

■ Impressum

IMAPS Deutschland e. V.
Kleingrötzing 1
D-84494 Neumarkt-St. Veit

1. Vorsitzender:

Prof. Dr.-Ing. Martin Schneider-Ramelow,
Institutsleiter Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM),
martin.schneider-ramelow@izm.fraunhofer.de
Schatzmeister (bei Fragen zu Mitgliedschaft und Beitrag): Ernst G. M. Eggelaar, ee@microtronic.de



Ausführliche Kontaktinformationen zu den Vorstandsmitgliedern finden Sie unter www.imaps.de (Vorstand)

Lötatmosphären für das Schmelzlöten mit temporär flüssigen Loten

Flussmittellöten und flussmittelfreies Löten

Von Prof. Klaus Wittke und Prof. Wolfgang Scheel. Erste Auflage 2014 mit 104 Seiten, 54 Abbildungen und 27 Tabellen. ISBN 978-3-87480-279-6. Preis € 60,- inkl. MwSt. zzgl. Porto und Verpackung.



Das vorliegende Buch ist kein Lehrbuch, sondern vielmehr eine Zusammenfassung aus der Fachliteratur, ergänzt mit den Erfahrungen und Entwicklungen der Autoren in der eigenen beruflichen Tätigkeit. Dabei wird das derzeitige Wissen um das Thema „Lötmedien“ neu strukturiert bzw. ergänzt. Das Buch ist für alle Interessierten auf dem Gebiet der Fügetechnik und Fertigungstechnik besonders empfehlenswert.

Die Hauptkapitel: 1: Lötmaterialien und schmelzlötbare Baugruppenoberflächen, 2: Stoff- und prozessspezifisches System der Lötmedien, 3: Stoff- und prozessspezifisches System der Aktivierungsverfahren, 4: Lötatmosphären für das Flussmittel-Schmelzlöten, 5: Lötatmosphären beim flussmittelfreien Schmelzlöten, 6: Lötatmosphären für das Übersoliduslöten, 7: Prozessatmosphären als lokale Lötatmosphären

Eugen G. Leuze Verlag KG

Karlstraße 4 | D-88348 Bad Saulgau
Tel. 07581/4801-0 | Fax 07581/4801-10
buchbestellung@leuze-verlag.de | www.leuze-verlag.de

